

**THIS PAGE IS INSERTED BY OIPE SCANNING
AND IS NOT PART OF THE OFFICIAL RECORD**

Best Available Images

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

BLACK BORDERS

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT

BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLORED PHOTOS HAVE BEEN RENDERED INTO BLACK AND WHITE

VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS

UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE THE BEST AVAILABLE
COPY. AS RESCANNING WILL NOT
CORRECT IMAGES, PLEASE DO NOT
REPORT THE IMAGES TO THE
PROBLEM IMAGE BOX.**

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004364887

WPI Acc No: 1985-191765/198532

XRAM Acc No: C88-032038

New polyepoxy resins and compsns. prep'd. from new polyether cpds. -
having excellent heat and water resistance and weatherability

Patent Assignee: DAICEL CHEM IND LTD (DAIL)

Inventor: INOUE K; MURAI T; WATANABE S; YAGII T

Number of Countries: 008 Number of Patents: 013

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP 150850	A	19850807	EP 85100950	A	19850130	198532	B
JP 60161973	A	19850823	JP 8414859	A	19840130	198540	
JP 60166675	A	19850829	JP 8414860	A	19840130	198541	
JP 60170620	A	19850904	JP 8427693	A	19840216	198542	
US 4565859	A	19860121	US 85696239	A	19850129	198606	
JP 63072721	A	19880402	JP 87224721	A	19840202	198819	
JP 88031493	B	19880624	JP 8427695	A	19840216	198829	
JP 1152119	A	19890614	JP 87189702	A	19840202	198930	
JP 92010471	B	19920225	JP 8414859	A	19840130	199212	
JP 92012889	B	19920306	JP 87189702	A	19870000	199214	
EP 150850	B1	19920909	EP 85100950	A	19850130	199237	
DE 3586597	G	19921015	DE 3586597	A	19850130	199243	
			EP 85100950	A	19850130		
JP 94025194	B2	19940406	JP 8414860	A	19840130	199417	

Priority Applications (No Type Date): JP 8427693 A 19840216; JP 8414859 A 19840130; JP 8414860 A 19840130; JP 87189702 A 19840202; JP 87224721 A 19840202; JP 8427695 A 19840216

Cited Patents: A3...8703; FR 2112217; GB 904549; No-SR.Pub; US 2765296;
1.Jnl.Ref

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 150850 A E 51

Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI

JP 92010471 B 8

JP 92012889 B 7

EP 150850 B1 E 25 C08G-065/26

Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI

DE 3586597 G C08G-065/26 Based on patent EP 150850

JP 94025194 B2 8 C07D-301/14 Based on patent JP 60161973

Abstract (Basic): EP 150850 A

A novel polyether cpd. (I) and a novel epoxy resin (II) are claimed: where R1 = organic cpd. residue having 1 active H atoms, n, through ne = 0 or 1-100, the sum of n, through ne = 1-100, e = 1-100, A = gp. (A) and B = an oxycyclohexane unit having a substit. and is represented by (III) where X = gp. IV, -CH=CH2 or V (R2 = alkyl, alkylcarbonyl, or arylcarbonyl gp.). An epoxy resin compsn. is formed by mixing (I) with a curing agent.

USE/ADVANTAGE - (i) (I) is useful as a resin with excellent hardness, strength and weatherability. (ii) cured prods. obtd. from (II) may be used as encapsulating agents for semiconductors, insulating varnishes, fibre-reinforced plastics, casting prods. mouldings, etc. (iii) cured prods. obtd. from (II) have excellent mechanical properties (e.g. tensile strength, hardness), electrical properties (e.g. anti-tracking property, anti-arc property) and heat distortion temp., and show low corrosion. (Additionally classified in section E).

0/0

Abstract (Equivalent): EP 150850 B

A process for producing a polyether compound having ether groups and vinyl double bonds represented by formula (I) wherein R1 represents a residue of an organic compound having 1 active hydrogen atoms, n1 through n2 each represents 0 or an integer of from 1 to 100, the sum of the integers represented by n1 through n2 is from 1 to 100, and l represents an integer of from 1 to 100, and A represents (II), in which the organic compound having active hydrogen atoms is reacted with 4-vinylcyclohexene-1-oxide in the presence of a catalyst, characterised in that the catalyst is selected from tetramethyl ammonium chloride, triphenyl phosphine, $BF_3 \cdot O(CH_2CH_3)_2$ and aluminum chloride. (Dwg.0/0)r

Abstract (Equivalent): US 4565859 A

Prodn. of an epoxy resin of formula (I) by reacting a cpd. of formula (II) with an epoxidating agent, e.g. peroxide or a peracid. Wherein R' is a residue of a phenol, a carboxylic acid, an amine, a thiol, or pref. an alcohol, having 1 active H-atoms, n'-nl are 1-100, l is 1-100, and (B), X is (X), (Y) or (Z), R2 is alkyl(carbonyl) or arylcarbonyl and (A).

USE/ADVANTAGE - Novel epoxy resins having excellent heat and water resistance and weatherability. (13pp)

Title Terms: NEW; POLYEPOXIDE; RESIN; COMPOSITION; PREPARATION; NEW; POLYETHER; COMPOUND; HEAT; WATER; RESISTANCE; WEATHER

Derwent Class: A21

International Patent Class (Main): C07D-301/14; C08G-065/26

International Patent Class (Additional): C07D-303/18; C07D-303/24; C08G-059/20; C08G-059/40; C08G-065/14; C08G-065/32; C08K-003/00; C08L-063/00; H01L-023/29

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-A04; A05-A05; A05-H; E07-A03B; E10-E04C

Plasdoc Codes (KS): 0011 0013 0016 0034 0035 0037 0203 0172 0226 1277 1279
1282 1609 1613 1615 1999 2000 2002 2014 2015 2020 2021 2022 2040 2063
2064 2073 2093 2124 2144 2152 2172 2182 2198 2212 2285 2287 2299 2302
2325 2382 2441 2462 2493 2511 2542 2545 2548 2551 2552 2559 3250 3251
2595 2597 2600 2605 2607 2622 2629 2648 2667 2718 2738 3279 2743

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 02& 028 039 05- 075 08& 106 140 147 15& 151 20- 204 226 231 239
24& 240 250 261 262 273 277 299 308 309 31- 311 331 335 336 341 344
346 347 355 359 368 393 398 402 405 431 456 458 473 475 476 477 479
506 509 510 512 516 52& 52- 523 53& 532 533 535 541 543 545 546 551
560 561 567 575 58& 58- 591 604 608 623 627 680 687 688 689 720 722
723 724

Chemical Fragment Codes (M3):

01 F012 F019 F100 F199 G010 G019 G020 G021 G029 G036 G039 G040 G111
G112 G113 G563 G599 H102 H161 H162 H163 H4 H403 H404 H405 H461 H462
H463 H481 H482 H483 H484 H541 H542 H543 H561 H562 H563 H581 H582
H583 H584 H589 H598 H715 H721 H722 H723 H8 J011 J012 J013 J014 J231
J232 J271 J272 J273 M116 M119 M126 M129 M141 M149 M210 M211 M212
M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232
M233 M240 M262 M271 M272 M273 M280 M281 M282 M283 M312 M320 M321
M322 M323 M332 M343 M373 M391 M392 M393 M413 M414 M415 M417 M510
M520 M521 M522 M523 M530 M531 M532 M533 M541 M542 M543 M710 M903
Q110 00012

Ring Index Numbers: 00012

Derwent Registry Numbers: 0876-U; 5155-U

PREPARATION OF NOVEL EPOXY RESIN

Patent Number: JP60161973
Publication date: 1985-08-23
Inventor(s): YANAGII TOYOKAZU; others: 03
Applicant(s): DAICEL KAGAKU KOGYO KK
Requested Patent: JP60161973
Application Number: JP19840014860 19840130
Priority Number(s):
IPC Classification: C07D303/14; C08G59/20; C08G65/32
EC Classification:
Equivalents: JP1897574C, JP6025194B

Abstract

NEW MATERIAL: An epoxy compound expressed by formula I {R1 is organic compound residue having I active H atoms; n1, n2...nl are integers 0-100, and the sum thereof is 1-100; I is an integer 1-100; B is expressed by formula II[X is expressed by formula III, IV or V (R2 is H, alkyl, alkylcarbonyl or arylcarbonyl)], and contains one or more groups expressed by formula III in the resin expressed by formula I }.

EXAMPLE: The compound expressed by formula VI (n is 2 on the average).

USE: An alicyclic epoxy resin compound, having rapidly curable terminal epoxy groups and improved heat resistance and electrical characteristics without containing chlorine, and applicable to preparation of large-scale integrated circuits (LSI) sealing materials, sealants for light emitting diodes (LED) and semiconductors and coating materials, etc.

PREPARATION: An unsaturated compound expressed by formula VII (A is cyclohexane skeleton having vinyl group of formula VIII) is reacted with an epoxidizing agent, e.g. peracetic acid, if necessary in a solvent at -70-+200 deg.C to give the aimed compound expressed by formula I .

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

⑪ 公開特許公報 (A) 昭60-161973

⑫ Int. Cl. 4

C 07 D 303/14
 C 08 G 59/20
 65/32
 // C 08 G 65/14

識別記号

府内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)8月23日

6640-4C
 6958-4J
 8319-4J
 8319-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

⑭ 発明の名称 新規なエポキシ樹脂の製造方法

⑮ 特願 昭59-14860

⑯ 出願 昭59(1984)1月30日

⑰ 発明者 楢井 豊和 大竹市玖波6-8-5
 ⑰ 発明者 渡辺 正治 大竹市玖波6-8-3
 ⑰ 発明者 井上 公夫 大竹市玖波4-11-7
 ⑰ 発明者 村井 孝明 大竹市玖波4-11-7
 ⑰ 出願人 ダイセル化学工業株式会社 堺市鉄砲町1番地

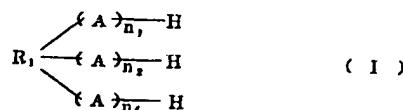
明細書

1. 発明の名称

新規なエポキシ樹脂の製造方法

2. 特許請求の範囲

一般式 (I) で表わされる不飽和化合物を、エポキシ化剤と反応させることを特徴とする一般式 (II) で表わされる新規なエポキシ樹脂の製造方法

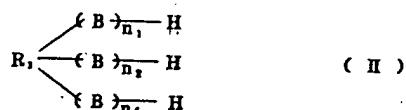
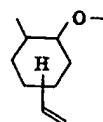


ただし R_1 は δ 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n_1, n_2, \dots, n_4 は 0 又は 1 ~ 100 の整数でその和が 1 ~ 100 である。

δ は 1 ~ 100 の整数をあらわす。

A は ビニル基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。

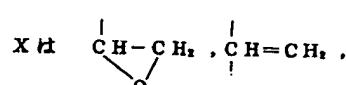
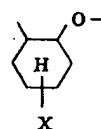


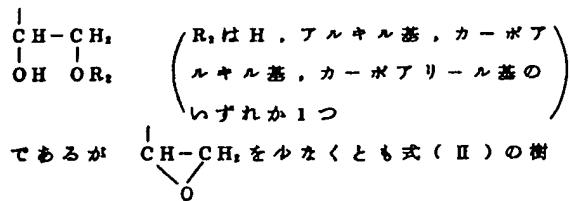
ただし R_1 は δ 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n_1, n_2, \dots, n_4 は 0 又は 1 ~ 100 の整数でその和が 1 ~ 100 である。

δ は 1 ~ 100 の整数をあらわす。

B は 置換基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。





脂中に 1 個以上含む。

3. 発明の詳細な説明

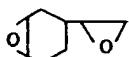
本発明は、耐熱性、耐水性、耐候性にすぐれた新規な脂環式エポキシ樹脂の製造方法に関する。

産業界において、現在最も広く使用されているエポキシ樹脂は、ビスフェノール A とエピクロルヒドリンとの反応によって製造されるところのエビ-ビス型エポキシ樹脂である。この樹脂は液体から固体までの幅広い製品が得られ、しかもエポキシ基の反応性は高く、常温でポリアミンによって硬化できるという利点をもつていて。しかしながらその硬化物は耐水性にすぐれ強じんであるという特徴にもかかわらず、耐候性が悪いこと、耐トラッキング性等の電気的性質が悪いこと、熱変

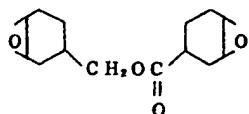
形温度が低いという欠点がある。特に最近超 LSI 等の封止用樹脂に、フェノールヤノボラック樹脂とエピクロルヒドリンと反応させたエポキシ樹脂が使用されているが、樹脂中に塩素が数 100 ppm 含まれそれが電子部品の電気特性を悪くする等の問題が起っている。

塩素を含まず、電気特性、耐熱性にすぐれたエポキシ樹脂としては、脂環式エポキシ樹脂がある。これらは 5 員環、6 員環のシクロアルケニル骨格を有する化合物のエポキシ化反応によって製造されている。これらの樹脂のエポキシ基は所謂、内部エポキシ基であり、通常酸無水物による加熱硬化が行なわれるが、反応性が低いため、ポリアミンによる常温硬化はできない。そのため、脂環式エポキシ樹脂の使用範囲を著しく狭いものにしている。

脂環式エポキシ樹脂としては(III)、(IV)の構造を有するものが工業的に製造され、使用されている。



(III)



(IV)

(III) はその粘度が非常に低いこと故に耐熱性エポキシ希釈剤に使用されているが毒性が強く、作業者の皮膚が著しくかぶれる等の問題がある。

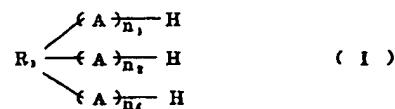
(IV) は不純物が少なく色相が低く、その硬化物の熱変形温度は高いがエステル結合に基づく耐水性の悪さが問題となっている。

さらに(III)、(IV)いずれも低粘度の液状エポキシ樹脂であるため、トランスファー成形等の固型エポキシ樹脂の成形システムを適用することができない。

本発明者等はこの点に鑑み観察研究を重ねた結果、ビニルシクロヘキサン骨格を有するポリエーテル化合物をエポキシ化剤と反応させることによって脂環骨格を有しながらも速硬化性の末端エポキ

シ基をもち、塩素を含まず、耐熱性、電気特性にすぐれたエポキシ樹脂を製造し得ることを見い出し本発明に至った。

即ち、本発明は一般式(Ⅰ)で表わされる不飽和化合物を、エポキシ化剤と反応させることを特徴とする一般式(Ⅱ)で表わされるエポキシ樹脂の製造方法に関する。

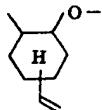


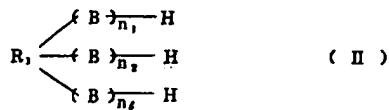
ただし R_1 は ℓ 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n_1, n_2, \dots, n_ℓ は 0 又は 1 ~ 100 の整数でその和が 1 ~ 100 である。

ℓ は 1 ~ 100 の整数をあらわす。

A はビニル基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。



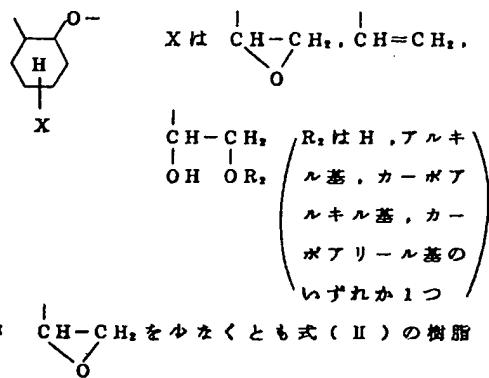


ただし R_1 は 8 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n_1, n_2, \dots, n_4 は 0 又は 1 ~ 100 の整数でその和が 1 ~ 100 である。

ℓ は 1 ~ 100 の整数をあらわす。

B は置換基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。



中に 1 個以上含む。

本発明の (II) 式であらわされる新規エポキシ樹脂の製造において (II) 式の R_1 は活性水素を有する有機物残基であるが、その前駆体である活性水素を有する有機物としては、アルコール類、フェノール類、カルボン酸類、アミン類、チオール類等があげられる。

アルコール類としては、1 倍のアルコールでも多価アルコールでもよい。

例えはメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、オクタノール等の脂肪族アルコール、ベンジルアルコール、のような芳香族アルコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジブロピレングリコール、1,3ブタジオール、1,4ブタジオール、ペシタンジオール、1,6ヘキサンジオール、ネオベンチルグリコール、オキシビパリン酸のネオベンチルグリコールエステル、シクロヘキサンジメタノール、グリセリン、ジグ

リセリン、ポリグリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、等がある。

フェノール類としては、フェノール、クレゾール、カテコール、ビロガロール、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ビスフェノール A、ビスフェノール F、4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、ビスフェノール S、フェノール樹脂、クレゾールノボラック樹脂等がある。

カルボン酸類としてはギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、動植物油の脂肪酸、フマル酸、マレイイン酸、アジビン酸、ドデカン 2 酸、トリメリット酸、ビロメリット酸、ポリアクリル酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等がある。また乳酸、クエン酸、オキシカブロン酸、等、水酸基とカルボン酸を共に有する化合物もあげられる。

アミン類としてはメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ベンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、オクチルアミン、ドデシルアミン、4,4'-ジアミノジフ

エニルメタン、イソホロンジアミン、トルエンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、キシレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、エタノールアミン等がある。

チオール類としては、メチルメルカプタン、エチルメルカプタン、プロピルメルカプタン、フェニルメルカプタン等のメルカブト類、メルカブトプロピオン酸あるいはメルカブトプロピオン酸の多価アルコールエステル、例えはエチレングリコールジメルカブトプロピオン酸エステル、トリメチロールプロパントリメルカブトプロピオン酸エステル、ペンタエリスリトールペンタメルカブトプロピオン酸エステル等があげられる。

さらにその他、活性水素を有する化合物としてはポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル部分加水分解物、デンプン、セルロース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート、ヒドロキシエチルセルロース、アクリルポリオール樹脂、ステレンアクリルアルコール共重合樹脂、ステレン-アレイン酸共重合樹脂、アルキッド樹脂、

ポリエステルポリオール樹脂、ポリエステルカルボン酸樹脂、ポリカブロラクトンポリオール樹脂、ポリブロビレンポリオール、ポリエトラメチレングリコール、等がある。

また活性水素を有する化合物は、その骨格中に不飽和2重結合を有していても良く、具体例としては、アリルアルコール、アクリル酸、メタクリル酸、3-シクロヘキセンメタノール、テトラヒドロフタル酸等がある。

この場合、エポキシ樹脂の一般式(II)に於て、不飽和2重結合は全部または一部エポキシ化されたものとなる。

一般式(II)における n_1 、 n_2 、…… n_k は0又は1～100の整数であり、その和が1～100であるがJ-100以上では融点の高い樹脂となり取り扱いにくく、実際上は使用できるようなものとはならない。

ℓ は1～100までの整数である。

式(II)におけるBの置換基Xのうち

$\backslash \text{CH}-\text{CH}_2$ が多ければ多い程好ましい。特に

$\backslash \text{CH}-\text{CH}$ は少なければ少ない程好ましい。

すなわち、本発明においては、置換基Xは、

$\backslash \text{CH}-\text{CH}_2$ が主なものである。

本発明の(II)式で表わされる新規エポキシ樹脂の製造は活性水素を有する有機化合物を開始剤にし4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドを開環重合させることによって得られるポリエーテル樹脂、すなわち、ビニル基側鎖を有するポリシクロヘキセンオキサイド重合体を過酸等の酸化剤すなわちエポキシ化剤でエポキシ化することによって行なうことができる。

4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドは、ブタジエンの2量化反応によって得られるビニルシクロヘキセンを過酢酸によって部分エポキシ化

するによって得られる。

4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドを活性水素存在下に重合させる時には触媒を使用することが好ましい。

触媒としてはメチルアミン、エチルアミン、ブロビルアミン、ビペラジン等のアミン類、ビリジン類、イミダゾール類、等の有機塩基類、ギ酸、酢酸、ブロビオン酸等の有機酸類、硫酸、塩酸等の無機酸、ナトリウムメチラート等のアルカリ金属類のアルコラート類、KOH、NaOH等のアルカリ類、BF₃、ZnCl₂、AlCl₃、SnCl₄等のルイス酸又はそのコンプレックス類、トリエチルアルミニウム、ジエチル亜鉛等の有機金属化合物をあげることができる。

これらの触媒は反応物に対して0.01～10%好ましくは0.1～5%の範囲で使用することが出来る。反応温度は-70～200℃好ましくは-30℃～100℃である。

反応は溶媒を用いて行なうこともできる。溶媒としては活性水素を有しているものは使用するこ

とができない。

すなわち、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族溶媒その他エーテル、脂肪族炭化水素、エステル類等を使用することができる。

さて、本発明においてはこのようにして合成したビニル基側鎖を有するポリシクロヘキセンオキサイド重合体をエポキシ化剤によってエポキシ化することによって式(II)の新規エポキシ樹脂を製造することを特徴とする。

エポキシ化剤としては過酸類、ハイドロバーオキシド類のどちらかを用いることができる。

過酸類としては、過ギ酸、過酢酸、過安息香酸、トリフルオロ過酢酸等を用いることができる。

このうち特に過酢酸は工業的に安価に入手可能でかつ安定度も高く、好ましいエポキシ化剤である。

ハイドロバーオキサイド類としては過酸化水素、ターシャリブチルハイドロバーオキサイド、ク

ポリエステルポリオール樹脂、ポリエステルカルボン酸樹脂、ポリカブロラクトンポリオール樹脂、ポリブロビレンポリオール、ポリエトラメチレングリコール、等がある。

また活性水素を有する化合物は、その骨格中に不飽和2重結合を有していても良く、具体例としては、アリルアルコール、アクリル酸、メタクリル酸、3-シクロヘキセンメタノール、テトラヒドロフタル酸等がある。

この場合、エポキシ樹脂の一般式(Ⅱ)に於て、不飽和2重結合は全部または一部エポキシ化されたものとなる。

一般式(Ⅱ)における n_1, n_2, \dots, n_d は0又は1~100の整数であり、その和が1~100であるがJ-100以上では融点の高い樹脂となり取り扱いにくく、実際上は使用できるようなものとはならない。

ℓ は1~100までの整数である。

式(Ⅱ)におけるBの置換基Xのうち

$\backslash \text{CH}-\text{CH}_2$ が多ければ多い程好ましい。特に
 $\backslash \text{CH}-\text{CH}_2$

$\backslash \text{CH}-\text{CH}$ は少なければ少ない程好ましい。
 $\text{OH} \quad \text{OR}_2$

すなわち、本発明においては、置換基Xは、

$\backslash \text{CH}-\text{CH}_2$ が主なものである。

本発明の(Ⅱ)式で表わされる新規エポキシ樹脂の製造は活性水素を有する有機化合物を開始剤にし4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドを開環重合させることによって得られるポリエーテル樹脂、すなわち、ビニル基側鎖を有するポリシクロヘキセンオキサイド重合体を過酸等の酸化剤すなわちエポキシ化剤でエポキシ化することによって行なうことができる。

4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドは、ブタジエンの2量化反応によって得られるビニルシクロヘキセンを過酢酸によって部分エポキシ化

することによって得られる。

4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドを活性水素存在下に重合させる時には触媒を使用することが好ましい。

触媒としてはメチルアミン、エチルアミン、ブロビルアミン、ビペラジン等のアミン類、ビリジン類、イミダゾール類、等の有機塩基類、ギ酸、酢酸、プロピオン酸等の有機酸類、硫酸、塩酸等の無機酸、ナトリウムメチラート等のアルカリ金属類のアルコラート類、KOH、NaOH等のアルカリ類、BF₃、ZnCl₂、AlCl₃、SnCl₄等のルイス酸又はそのコンプレックス類、トリエチルアルミニウム、ジエチル亜鉛等の有機金属化合物をあげることができる。

これらの触媒は反応物に対して0.01~10%好ましくは0.1~5%の範囲で使用することが出来る。反応温度は-70~200℃好ましくは-30℃~100℃である。

反応は溶媒を用いて行なうこともできる。溶媒としては活性水素を有しているものは使用するこ

とができない。

すなわち、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族化合物その他エーテル、脂肪族炭化水素、エステル類等を使用することができる。

さて、本発明においてはこのようにして合成したビニル基側鎖を有するポリシクロヘキセンオキサイド重合体をエポキシ化剤によってエポキシ化することによって式(Ⅱ)の新規エポキシ樹脂を製造することを特徴とする。

エポキシ化剤としては過酸類、ハイドロバーオキシド類のどちらかを用いることができる。

過酸類としては、過ギ酸、過酢酸、過安息香酸、トリフルオロ過酢酸等を用いることができる。

このうち特に過酢酸は工業的に安価に入手可能でかつ安定度も高く、好ましいエポキシ化剤である。

ハイドロバーオキサイド類としては過酸化水素、ターシャリブチルハイドロバーオキサイド、ク

メンバーオキサイド等を用いることができる。

エポキシ化の際には必要に応じて触媒を用いることができる。例えば過酸の場合、炭酸ソーダなどのアルカリや硫酸などの酸を触媒として用い得る。またハイドロバーオキサイドの場合、タングステン酸と苛性ソーダの混合物を過酸化水素と、あるいは有機酸を過酸化水素と、あるいはモリブデンヘキサカルボニルをターシャリブチルハイドロバーオキサイドと使用して触媒効果を得ることができる。

エポキシ化反応は、装置や原料物性に応じて溶媒使用の有無や反応温度を調節して行なう。

用いるエポキシ化剤の反応性によって、使用できる反応温度域は定まる。

好ましいエポキシ化剤である過酢酸についていえば、0～70℃が好ましい。0℃以下では反応が遅く、70℃以上では過酢酸の分解を起する。

また、ハイドロバーオキサイドの一例であるターシャリブチルハイドロバーオキサイド／モリブデン二酸化物ジアセチルアセトナート系では、同

じ理由で20～150℃が好ましい。

溶媒は、原料粘度の低下、エポキシ化剤の希釈による安定化等の目的で使用することが出来る。

過酢酸の場合であれば、芳香族化合物、エーテル化合物、エステル化合物、ケトン化合物等を溶媒として用いることができる。

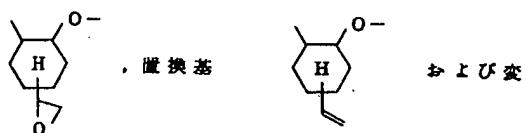
不飽和結合に対するエポキシ化剤の仕込みモル比は、不飽和結合をどれ位残存させたいか等の目的に応じて変化させることが出来る。エポキシ基が多い化合物が目的の場合、エポキシ化剤は不飽和基に対し等モルかそれ以上加えるのが好ましい。

但し、経済性および次に述べる副反応の問題から2倍モルを越えることは通常不利であり、過酢酸の場合、1～1.5倍モルが好ましい。

エポキシ化反応の条件によって、オレフィン結合のエポキシ化と同時に原料中の置換基

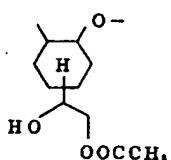


がエポキシ化剤等と副反応を起こした結果、変性された置換基が生じ、目的化合物中に含まれてくる。目的化合物中の置換基



成された置換基の3者の比はエポキシ化剤の種類、エポキシ化剤とオレフィン結合のモル比、反応条件によって定まる。

変成された置換基は、例えば、エポキシ化剤が過酢酸の場合、下の様な構造のものが主であり、生成したエポキシ基と、副生した酢酸から生じる。



機械等の通常の化学工学的手段によって、目的化合物を反応粗液から取り出すことができる。

本発明によって得られる新規なエポキシ樹脂は一般に混合物として得られる場合が多い。

このようにして得られた新規なエポキシ化合物は、フェノールノボラック樹脂やその他の硬化剤によって架橋させることによって、その塩素不純物の低さから優れたLSI封止材料として用いることができる。

またコイルの含浸等のエポキシドの従来の用途の代替としても重合度等を自由に調整することにより、性能を適合させることができる長所を有している。さらにLEDや半導体の封止剤、塗料等、幅広い用途に適用できる。

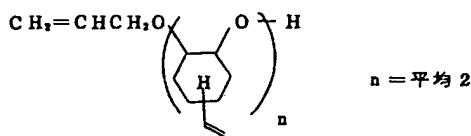
以下に実施例をあげて、さらに本発明を詳しく説明する。

実施例-1

アリルアルコール 116g(2モル)、4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイド 496g(4モル)およびBF₃エーテラート 3.1gを60℃で混合し、ガスクロマトグラフィー分析で4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイドの転

化率が9.8%以上になるまで反応させた。得られた反応粗液に酢酸エチルを加えて水洗し、次に酢酸エチル層を濃縮して粘稠液体を得た。

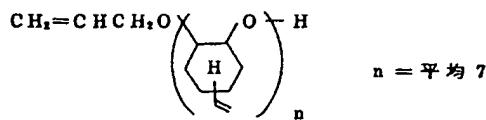
生成物の赤外線吸収スペクトルにおいて、原料に見られた810, 850cm⁻¹のエポキシ基による吸収が無くなっていること、1080, 1150cm⁻¹にエーテル結合による吸収が存在すること、ガスクロマトグラフィー分析で、生成物中のアリルアルコールはこん跡量であるが赤外線吸収スペクトルで3450cm⁻¹にOH基の吸収があることから本化合物は下式で示される構造であることが確認された。



この化合物434gを酢酸エチルに溶解して反応器に仕込み、これに過酢酸388gを酢酸エチル溶液として2時間にわたって滴下した。この間

応させ、粘稠な液状の生成物を得た。

生成物の赤外線吸収スペクトルにおいて、原料に見られた810, 850cm⁻¹のエポキシ基による吸収が無くなっていること、1080, 1150cm⁻¹にエーテル結合による吸収が存在すること、ガスクロマトグラフィー分析で、生成物中のアリルアルコールはこん跡量であるが赤外線吸収スペクトルで3450cm⁻¹にOH基の吸収があることから本化合物は下式で示される構造であることが確認された。



さらに実施例-1と同様にこの化合物49.2gと過酢酸395gの反応を行ない、粘稠な透明液体を得た。

この化合物はオキシラン酸素含有率が9.27%で、赤外線吸収スペクトルで1260cm⁻¹にエポキシ基による特徴吸収が見られた。さらに、

反応温度は40℃に保つた。過酢酸の仕込み終了後、40℃でさらに6時間熟成した。

反応粗液に酢酸エチルを追加し、炭酸ソーダ416gを含むアルカリ水で洗い、続いて蒸留水でよく洗浄した。

酢酸エチル層を濃縮し、粘稠な透明液体を得た。この化合物はオキシラン酸素含有率が9.97%で、赤外線吸収スペクトルで1260cm⁻¹にエポキシ基による特徴吸収が見られた。さらに、1640cm⁻¹に残存ビニル基による吸収が見られること、3450cm⁻¹にOH基、1730cm⁻¹に、

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{---} \end{array} \text{CO-}$ 基による吸収が見られることから本化合物は一般式(I)の構造(R₁:グリシジル基またはアリル基, n=平均2, エポキシ基に酢酸が付加した基を一部含む)であることを確認した。

実施例-2

実施例-1と同様の操作で、アリルアルコール58g, 4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイド868g, BF₃・エーテラート4.7gを反

1640cm⁻¹に残存ビニル基による吸収が見られること、3450cm⁻¹にOH基、1730cm⁻¹に

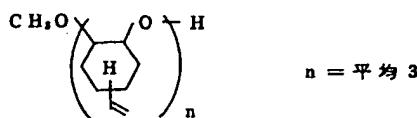
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{---} \end{array} \text{CO-}$ 基による吸収が見られることから本化合物は一般式(I)の構造(R₁:グリシジル基またはアリル基, n=平均7, エポキシ基に酢酸が付加した基を一部含む)であることを確認した。

実施例-3

実施例-1と同様な操作で、メタノール64g, 4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイド744g, BF₃・エーテラート4.1gを反応させ、粘稠な液状の生成物を得た。

生成物の赤外線吸収スペクトルにおいて、原料に見られた810, 850cm⁻¹のエポキシ基による吸収が無くなっていること、1080, 1150cm⁻¹にエーテル結合による吸収が存在すること、ガスクロマトグラフィー分析で、生成物中のアリルアルコールはこん跡量であるが赤外線吸収スペクトルで3450cm⁻¹にOH基の吸収があることから本化合物は下式で示される構造であることが

確認された。



さらに実施例-1と同様にこの化合物5.73gと過酢酸3.87gの反応を行ない、粘稠な透明液体を得た。

この化合物はオキシラン酸素含有率が9.03%で、赤外線吸収スペクトルで1260cm⁻¹にエポキシ基による特性吸収が見られた。さらに、

1640cm⁻¹IC残存ビニル基による吸収が見られること、3450cm⁻¹ICOH基、1730cm⁻¹IC

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{CO}- \end{array}$

基による吸収が見られることから本化合物は一般式(I)の構造(R₁:メチル基, n=平均3, エポキシ基に酢酸が付加した基を1部含む)であることを確認した。

参考例

実施例1, 2, 3で合成したエポキシ樹脂中の

全塩素量の測定を行った。

測定は試料約2gを秤量し、硫酸ボンベで分解・燃焼して測定し、表1の結果を得た。エピクロルヒドリンを出発原料とした、通常のエポキシ樹脂においては全塩素は通常数百ppm程度含まれている事を考えれば、本発明の樹脂の全塩素は非常に少い事がわかる。

表1 エポキシ樹脂中の全塩素量

エポキシ樹脂	実施例1 の生成物	実施例2 の生成物	実施例3 の生成物
全塩素量(ppm)	1.0	1.5	1.3

応用例1

実施例1, 2, 3の生成物に硬化剤を配合してゲルタイムを測定し、エポキシ樹脂の硬化性の検討を行った。硬化剤としてノボラック型フェノール樹脂(PSF-4300群栄化学工業(株))を用い、硬化触媒として2-ウンデシルイミダゾール

表2 配合物のゲルタイム

エポキシ 樹脂	実施例1 の生成物	実施例2 の生成物	実施例3 の生成物	セロキサイド 2021
ゲルタイム	12分40秒	9分50秒	20分20秒	23分10秒

応用例2

実施例1, 2, 3の化合物を用いて硬化物の物性測定を行った。

硬化剤及び硬化触媒は応用例1と同じものを用い、下記の配合処方を応用例1と同様な方法で混合を行い、配合物を得た。得られた配合物を粉碎し、プレス成型によって試験片を得た。成型は90~100kgf/cm²の加圧下で、60℃より170℃まで約30分で昇温し、更に加圧下170℃で10分放置後、180℃に設定したオーブン中で2時間後硬化を行った。得られた硬化物を切削加工によって試験片とし、JIS-K-6911によって物性の測定を行い、表3の結果を得た。

(キュアゾールC₁₁Z、四国化成工業(株))を用いた。又、比較用樹脂として、代表的な脂環式エポキシ樹脂である3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3',4'-エポキシシクロヘキサンカルボキシラート(セロキサイド2021、ダイセル化学工業(株))を用い、下記の配合処方で配合を行い、120℃で約1分間溶融混合した後冷却して配合物を得た。得られた配合物をJIS-C2104-7(熱板法)によって120℃に於けるゲルタイムを測定し、表2の結果を得た。本発明の樹脂は従来の脂環式エポキシ樹脂よりも硬化性が高い事がわかる。

配合処方	エポキシ樹脂	1.0 当量
	PSF-4300	1.0 当量
	キュアゾールC ₁₁ Z (配合物に対して)	0.7 重量%

配合处方 エポキシ樹脂 1.0 当量
 PSF-4300 0.9 当量
 キュアゾールG₁₁Z (配合物に対して)
 0.7 重量%

特開昭60-161973(8)

手 紙 補 正 書 (自発)

昭和60年3月15日

特許庁長官 志賀 学 殿

表3 硬化物の物性

性状	実施例1 の生成物	実施例2 の生成物	実施例3 の生成物
吸水率(%)	0.22	0.26	0.21
熱変形温度(℃)	131	192	134
体積固有抵抗(MΩcm)	9.0×10 ⁹	1.2×10 ¹⁰	1.6×10 ¹⁰

1. 事件の表示

昭和59年特許願第14860号

2. 発明の名称

新規なエポキシ樹脂の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

郵便番号 590

住所 大阪府堺市鉄道町1番地

名称 (290) ダイセル化学工業株式会社

代表者氏名 久保田 美文

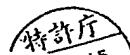


4. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄。

5. 補正の内容

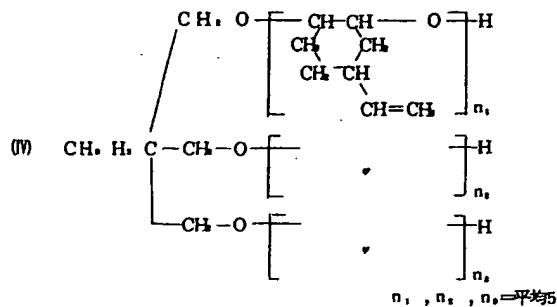
明細書の第27頁表3の次に以下の「実施例-4」
を追加する。



実施例-4

トリメチロールプロパン 134g (1モル)、ビニルクロヘキセンモノエポキシド 18.63g (1.6モル)を実施例-1と同様の方法にて反応させ生成物を得た。

得られた生成物を元素分析、IR、NMRにより分析したところ式(IV)で示される構造であることを確認した。



IR分析では実施例-1と同様 810, 850 および 1850 cm⁻¹ のエポキシ基の吸収は消失し、1080 cm⁻¹ のエーテル結合の吸収が新らしく生成した。さらには、910 cm⁻¹, 1640 cm⁻¹ のビニル基の吸収が残存している。

NMRでは、実施例1と同様のピークが確認された。元素分析値を次に示す。

分析値	C	H
7 6.0 5		9.6 5
7 5.8 2		9.7 3

以上の結果より式(IV)の構造を確認した。

さらに実施例-1と同様にこの化合物 573g と過酢酸 387g の反応を行ない、粘稠な透明液体を得た。

この化合物はオキシラン環素含有率が 9.03 % で、赤外線吸収スペクトルで 1260 cm⁻¹ にエポキシ基による特性吸収が見られた。さらに、

1640 cm⁻¹ に残存ビニル基による吸収が見られること、3450 cm⁻¹ にOH基、1730 cm⁻¹ に

O

-CO-基による吸収が見られることから本化合物は一般式(I)の構造 (R₁: トリメチロールプロパン残基, n = 3, n₁, n₂, n₃ = 平均 5, エポキシ基に酢酸が付加した基を 1 部含む) であることを確認した。

「アリロキシ基」と訂正する。

④ 同第20頁下から2~1行目の「オキサイド」を「オキシド」と訂正する。

④ 同第22頁4行目の「一般式(I)」を「一般式(II)」と訂正する。

④ 同第22頁4行目の「グリシジル基」を「グリシジルエーテル基」と訂正する。

④ 同第22頁5行目の「アリル基」を「アリロキシ基」と訂正する。

④ 同第22頁9行目の「オキサイド」を「オキシド」と訂正する。

④ 同第22頁下から4~3行目の「アリルアルコール」を「メタノール」と訂正する。

④ 同第23頁下から5行目の「一般式(I)」を「一般式(II)」と、同下から5行目の「メチル基」を「メトキシ基」とそれぞれ訂正する。

④ 同第24頁1行目の「行つた。」を「行なつた。」と訂正する。

④ 同第24頁7行目の「少い事」を「少ない事」と訂正する。

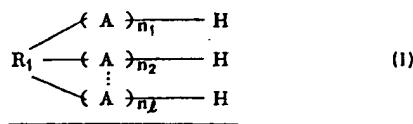
④ 同第26頁下から4行目の「行つた。」を

「行なつた。」と訂正する。

④ 同第27頁1行目の「キュアゾールG₁₁Z」を「キュアゾールC₁₁Z」と訂正する。

特許請求の範囲

一般式(II)で表わされる不飽和化合物を、エポキシ化剤と反応させることを特徴とする一般式(II)で表わされる新規なエポキシ樹脂の製造方法

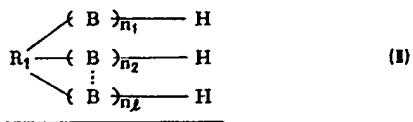
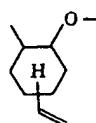


ただしR₁は ℓ 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n_1, n_2, \dots, n_3 は0又は1~100の整数でその和が1~100である。

ℓ は1~100の整数をあらわす。

Aはビニル基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。

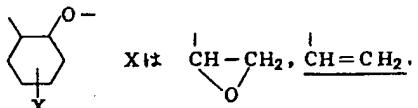


ただしR₁は ℓ 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n_1, n_2, \dots, n_3 は0又は1~100の整数でその和が1~100である。

ℓ は1~100の整数をあらわす。

Bは置換基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。



$\begin{array}{c} \text{CH}-\text{CH}_2 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$ R_2 はH、アルキル基、アルキルカルボニル基、
 --- ビニル基、アリールカルボニル基の
 O いずれか1つ

であるが $\text{CH}-\text{CH}_2$ を少なくとも式(II)の樹脂中に
 O 1個以上含む。

